

Title (en)

ZIF SOCKET FOR CHIP CARRIERS.

Title (de)

CHIPTRÄGERFASSUNG MIT EINER EINSTECKKRAFT GLEICH NULL.

Title (fr)

DOUILLE ZIF POUR SUPPORTS DE PUCES.

Publication

**EP 0185708 A1 19860702 (EN)**

Application

**EP 85902906 A 19850531**

Priority

US 62715084 A 19840702

Abstract (en)

[origin: WO8600777A1] A ZIF socket for chip carriers is taught. Briefly stated, a chip carrier socket housing (12) has sidewalls (24) which are inwardly pivotable. Accordingly, upon the placement of a chip carrier (14) having conductive leads (22) thereon into the chip carrier housing a retainer lid (10) is placed over the chip carrier and the housing. The retainer lid has a latching portion (20) which interacts with a tab (26) on the outside portion of the movable socket walls such that, upon downward urging of the retainer lid, the movable walls are urged inwards thereby moving contacts contained inside the housing into engagement with the conductive pads on the chip carrier.

Abstract (fr)

Une douille ZIF (force d'insertion zéro) pour des supports de puces se compose d'un boîtier (12) ayant des parois latérales (24) pouvant pivoter vers l'intérieur. En conséquence, en disposant un support de puce (14) présentant des conducteurs (22) dans le boîtier de support de puce, un couvercle de retenue (10) est placé sur le support de puce et sur le boîtier. Le couvercle de retenue présente une partie de verrouillage (20) qui coopère avec une patte (26) se trouvant sur la partie extérieure des parois mobiles de la douille de sorte que, en sollicitant vers le bas le couvercle de retenue, les parois mobiles sont sollicitées vers l'intérieur déplaçant ainsi les contacts contenus dans le boîtier et les engageant avec les plots conducteurs prévus sur le support de puce.

IPC 1-7

**H05K 7/10**

IPC 8 full level

**H01L 23/32** (2006.01); **H01R 24/00** (2006.01); **H01R 33/96** (2006.01); **H01R 33/97** (2006.01); **H05K 7/10** (2006.01)

CPC (source: EP KR)

**H05K 7/10** (2013.01 - KR); **H05K 7/1007** (2013.01 - EP)

Citation (search report)

See references of WO 8600777A1

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 8600777 A1 19860130**; BR 8506809 A 19861125; EP 0185708 A1 19860702; ES 296073 U 19870716; ES 296073 Y 19880116; JP H0340900 B2 19910620; JP S61502648 A 19861113; KR 860700335 A 19860801

DOCDB simple family (application)

**US 8501013 W 19850531**; BR 8506809 A 19850531; EP 85902906 A 19850531; ES 296073 U 19850701; JP 50240885 A 19850531; KR 860700128 A 19860228